

产品介绍

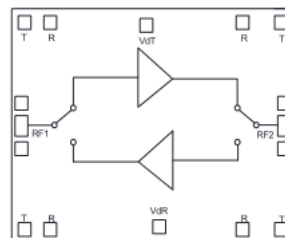
YPA58-0618SC1 是一款6~18GHz宽带双向放大器芯片，内部通过单刀双掷开关控制信号的发射或接收方向，放大器单电源供电，信号输入输出端均已集成隔直电容。广泛应用于无线通信。

关键技术指标

- 频率范围：6GHz~18GHz
- 增益：17dB
- 1dB压缩点输出功率：19dBm
- 电压/电流：+5V/120mA
- 芯片尺寸：2.25 mm×1.75 mm

应用领域

- 通信



YPA58-0618SC1功能框图



绝对额定最大值

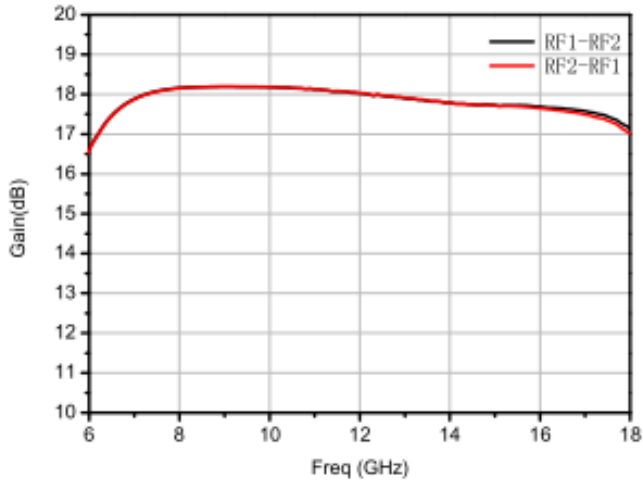
工作电压	+7V
控制电压	低电平：0~0.5V 高电平：3~5V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

电性能表 (T_A=+25°C, V_{dd}=+5V)

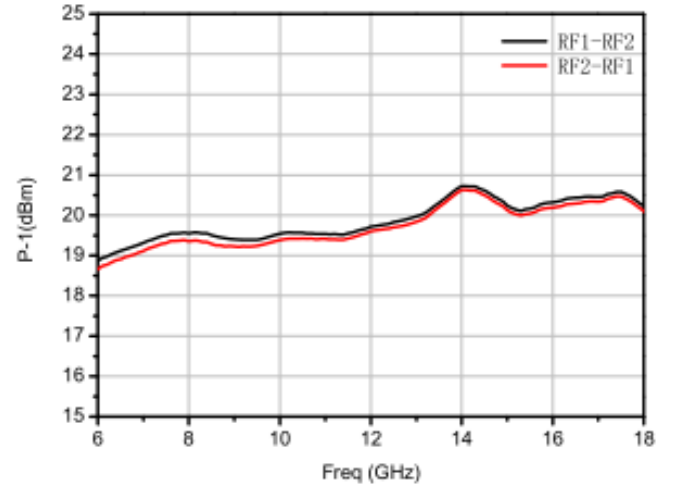
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	6		18	GHz
增益		17		dB
反向隔离度		50		dB
增益平坦度		±0.5		dB
RF1端口驻波		1.4		-
RF2端口驻波		1.4		-
噪声系数		8		dB
1dB压缩点输出功率		19		dBm
静态电流		120		mA

测试曲线 (T_A=+25°C)

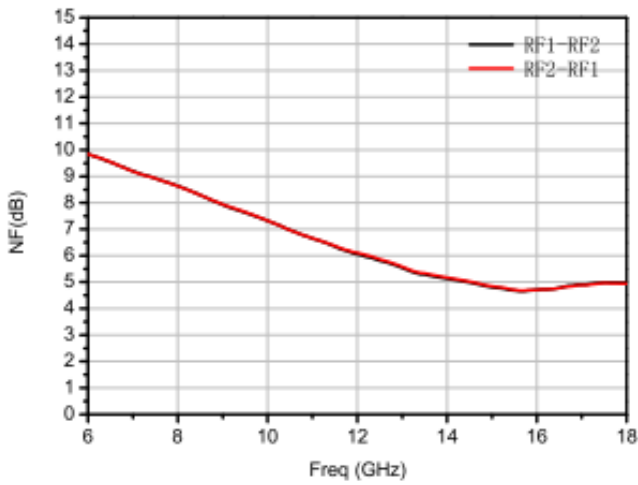
增益



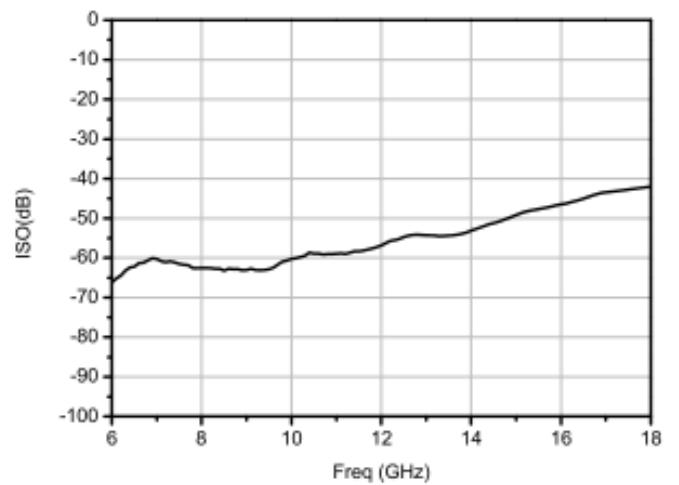
1dB 压缩点输出功率



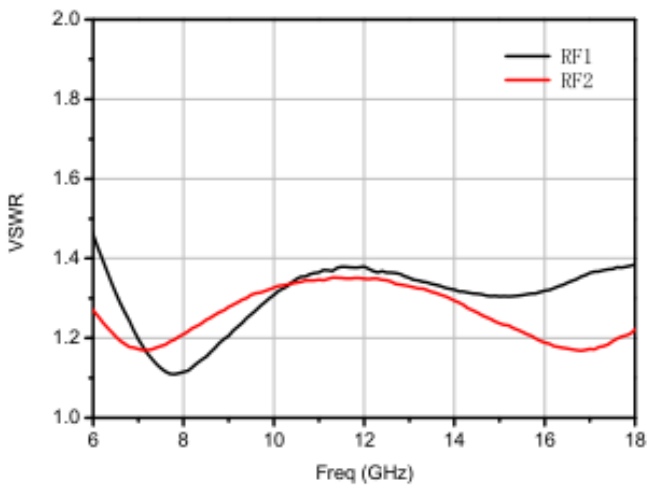
噪声系数



反向隔离度



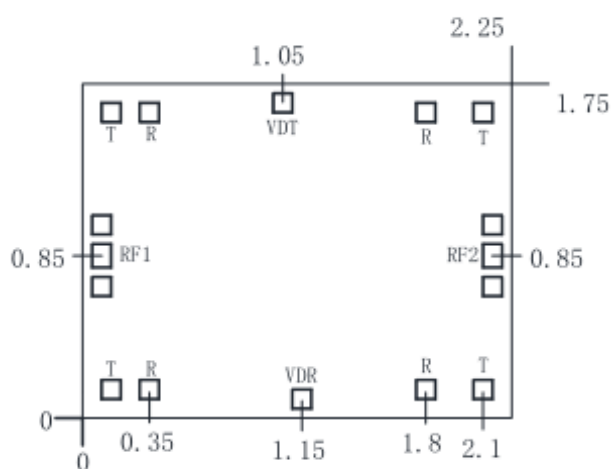
驻波



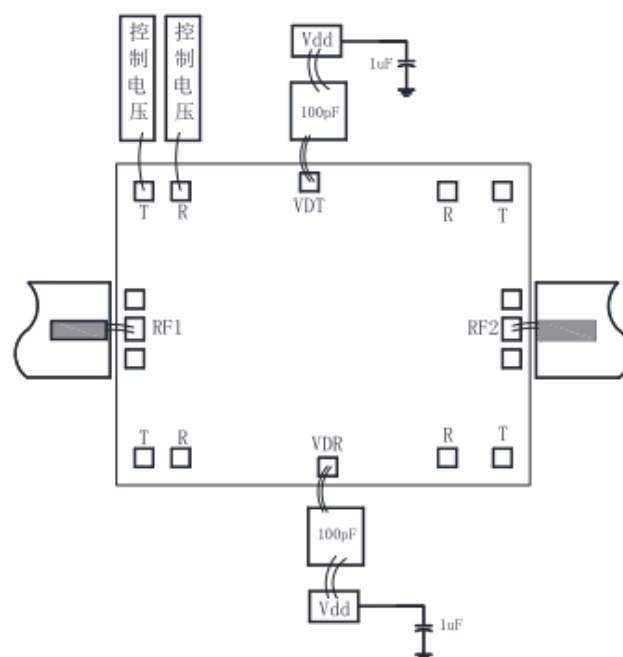
开关控制真值表

T	R	VDT	VDR	放大状态
3~5V	0	5V	0	RF1-RF2
0	3~5V	0	5V	RF2-RF1

外形和端口尺寸(mm)



建议装配图



注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

定义

极限值定义

极限值是根据绝对最大额定值系统 (IEC 60134) 给出的。压力高于一个或多个极限值，会造成对该产品的永久性损坏。这些是压力额定值，并且以这些额定值或者其它任何高于规定额定值的条件去操作器件将得不到任何保证。长时间的极限值操作可能会影响产品的可靠性。

使用方法

在此描述的产品的使用方法仅起说明作用。在没有进一步测试或修正的情况下，益丰不作任何陈述或保证：这些使用方法将适用于特定用途。

免责声明

生命保障类应用

这些产品并非为生命保障应用、器件或系统而设计的，因此，这些产品的故障可能会导致人身伤害。

若益丰的客户在生命保障类应用中使用或销售这些产品，应自担风险，并同意全部赔偿此类应用给益丰公司造成的任何损失。

修改权限

益丰公司持有对产品做出修改的权利，恕不另行通知，修改包括对电路、标准单元或软件进行设计或性能修改。除非另有说明，益丰公司对这些产品的使用不承担任何责任或义务，不在任何专利、版权、或侵权下转让许可或权利，也不会做出任何陈述或保证：这些产品不受专利、版权或侵权限制。

采购信息

编号	封装	版本	分类	描述
YPA58-0618SC1	裸芯片	C1	MMIC	6 – 18 GHz 宽带双向放大器